

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2022-018

深南电路股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	深南电路	股票代码	002916
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张丽君	谢丹	
办公地址	深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼		深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼
传真	0755-86096378	0755-86096378	
电话	0755-86095188	0755-86095188	
电子信箱	stock@scc.com.cn		stock@scc.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介

一、报告期内公司所处的行业情况

深南电路成立于1984年，始终专注于电子互联领域，经过三十余年的深耕与发展，拥有印制电路板、电子装联、封装基板三项业务。公司已成为中国印制电路板行业的领先企业，中国封装基板领域的先行者，电子装联特色企业，系国家火炬计划重点高新技术企业、印制电路板行业首家国家技术创新示范企业和国家企业技术中心、中国电子电路行业协会（CPCA）理事长单位及标准委员会会长单位。

目前，公司已成为全球领先的无线基站射频功放PCB供应商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商、电子装联制造的特色企业。根据2021年第一季度Prismark行业报告显示，2020年公司在全球印制电路板厂商中位列第八。

1、印制电路板（含封装基板）行业发展情况

根据Prismark2021年第四季度报告统计，受大宗商品涨价、美元贬值以及终端需求提升等多方面因素影响，2021年以美

元计价的全球PCB产业产值同比上升23.4%（按人民币计价产值同比增长15.6%；后文如无特殊说明，均指以美元计价）。从中长期看，产业将保持稳定增长的态势。2021年-2026年全球PCB产值的预计年复合增长率达4.8%。从区域看，全球各区域PCB产业均呈现持续增长态势。其中，中国大陆地区在2021年基数较高的情况下，复合增长率仍将达到4.6%，增长保持稳健。从产品结构看，封装基板、8-16层的高多层板、HDI板仍将保持相对较高的增速，未来五年复合增速分别为8.6%、4.4%、4.9%。

2021-2026年PCB产业发展情况预测（按地区）

单位：百万美元

类型/年份	2020	2021E		2026E	2021-2026E
	产值	同比	产值	产值	复合增长率
美洲	2,943	10.8%	3,261	3,780	3.0%
欧洲	1,613	27.3%	2,053	2,381	3.0%
日本	5,771	26.6%	7,308	9,277	4.9%
中国大陆	35,009	24.6%	43,616	54,605	4.6%
亚洲（日本、中国大陆除外）	19,883	21.8%	24,212	31,516	5.4%
合计	65,219	23.4%	80,449	10,1559	4.8%

数据来源：Prismark 2021 Q4报告

2021-2026年PCB产业发展情况预测（按产品）

单位：百万美元

类型/年份	2020	2021E		2026E	2021-2026E
	产值	同比	产值	产值	复合增长率
纸基板	862	10.0%	949	1,026	1.6%
单面板	1,717	17.8%	2,021	2,332	2.9%
双面板	5,333	19.6%	6,378	7,422	3.1%
4层板	8,772	25.5%	11,009	12,611	2.8%
6层板	6,171	24.5%	7,683	9,290	3.9%
8-16层板	8,421	26.7%	10,669	13,201	4.4%
18层及以上的高层板	1,402	20.7%	1,692	2,052	3.9%
HDI板	9,874	19.4%	11,791	15,012	4.9%
封装基板	10,190	39.4%	14,198	21,434.7	8.6%
软板	12,483	12.6%	14,058	17,179	4.1%
合计	65,194	23.4%	80,449	101,559	4.8%

数据来源：Prismark 2021 Q4报告

从下游需求看，伴随5G通信、人工智能、云计算、智能穿戴、智能家居等技术的持续升级与应用的不拓展，全球对于芯片以及芯片封装的需求大幅增长。封装基板作为芯片封装的重要材料，也随下游各应用领域需求的不断增加而进入高速发展期，市场前景良好。同时，受中美经贸摩擦、新冠疫情等因素影响，国内半导体产业链投资建设力度加大，对封装基板的需求不断增加。据Prismark预测，2021至2026年，封装基板为印制电路板行业内增速最高的品种，其中中国大陆地区封装基板复合增速为11.6%，增速高于其他地区。

对于PCB产品，无线通信、服务器和数据存储、新能源和智能驾驶以及消费电子等市场仍将是行业长期的重要增长驱动力。伴随5G时代下物联网、AI、智能穿戴等新型应用场景的不断涌现，各类终端应用也带来数据流量的激增，在下游电子产品拉升PCB用量的同时，还进一步驱动PCB向高速、高频和集成化、小型化、轻薄化的方向发展。高多层、高频高速、HDI、刚挠等中高阶PCB产品的需求将持续增长。

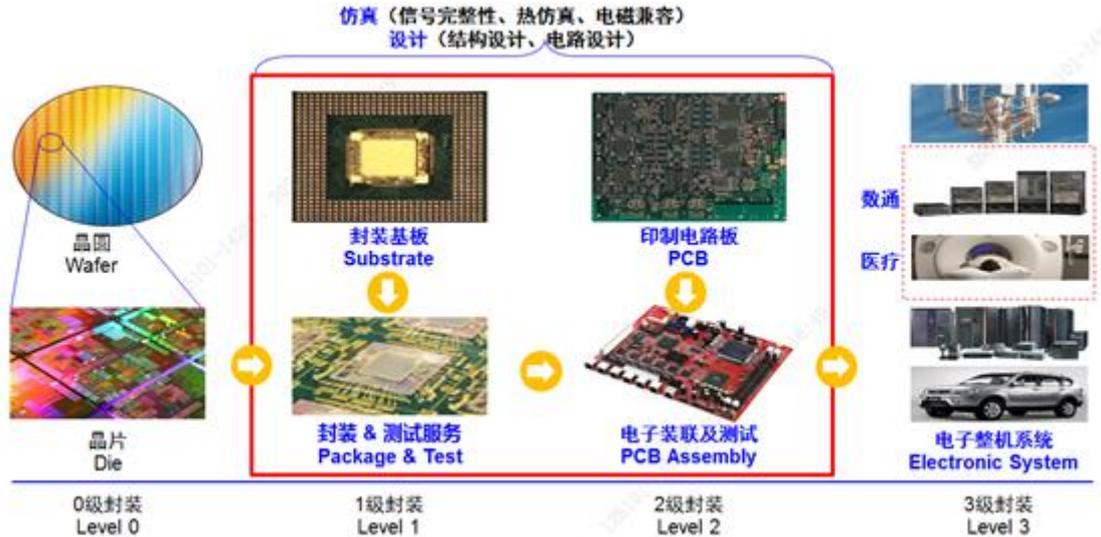
2、电子装联行业发展状况

电子装联在行业上属于EMS行业，行业狭义上指为各类电子产品提供制造服务的产业，代表制造环节的外包。目前全球EMS行业的市场集中度相对较高，国际上领先的EMS厂商均具备为品牌商客户提供涵盖电子产品设计、工程开发、原材料采购和管理、生产制造、测试及售后服务等多项除品牌、销售以外服务的能力。电子装联行业供应链较为复杂，涉及包括PCB、芯片、主被动元件等在内的各种电子元器件，故供应链更容易受到上游零件短缺的冲击，因此供应链能力也逐渐成为电子装联行业的核心竞争力之一。

2021年以来，全球经济回暖拉动需求增长，而各国疫情防控形势分化导致电子产业全球供应链的生产与物流都受到抑制。上述因素使得电子产业全年都面临芯片等电子元器件供需失衡的挑战，截至目前供应短缺虽已有所好转，但结构性短缺仍然存在。

二、主要业务、主要产品及其用途

深南电路始终专注于电子互联领域，致力于“打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商”，拥有印制电路板、电子装联、封装基板三项业务，形成了业界独特的“3-In-One”业务布局。公司以互联为核心，在不断强化印制电路板业务领先地位的同时，大力发展与其“技术同根”的封装基板业务及“客户同源”的电子装联业务。公司业务覆盖1级到3级封装产业链环节，具备提供“样品→中小批量→大批量”的综合制造能力，通过开展方案设计、制造、电子装联、微组装和测试等全价值链服务，能够为客户提供专业高效的一站式综合解决方案。封装基板、印制电路板和电子装联（含电子整机/系统总装）所处产业链环节如下图所示：



1、印制电路板产品

印制电路板（Printed Circuit Board，简称“PCB”）是指在覆铜板按照预定设计形成铜线路图形的电路板，其主要功能是使各种电子零组件按照预定电路连接，起电气连接作用。印制电路板是组装电子零件用的关键互连件，不仅为电子元器件提供电气连接，也承载着电子设备数字及模拟信号传输、电源供给和射频微波信号发射与接收等功能，绝大多数电子设备及产品均需配备，因而被称为“电子产品之母”。公司在印制电路板业务方面专业从事中高端印制电路板的设计、研发及制造等相关工作，产品下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。

公司PCB产品重点应用领域

应用领域		主要设备	相关PCB产品	特征描述
通信	无线网	通信基站	背板、高速多层板、高频微波板、多功能金属基板	金属基、大尺寸、高多层、高频材料及混压
	传输网	OTN传输设备、微波传输设备	背板、高速多层板、高频微波板	高速材料、大尺寸、高多层、高密度、多种背钻、刚挠结合、高频材料及混压
	核心网	路由器、交换机	背板、高速多层板、高频微波板	高速材料、大尺寸、高多层、高密度、多种背钻、刚挠结合、高频材料及混压
	固网宽带	OLT、ONU等光纤到户设备	背板、高速多层板	多层板、刚挠结合
数据中心	交换机、服务器/存储设备	背板、高速多层板	高速材料、大尺寸、高多层、高密度、多种背钻、刚挠结合	
工控医疗	工控、医疗系统	高速多层板	高可靠性、多层板、刚挠结合	
消费电子	电池保护、光学摄像、无线耳机等	刚挠结合板、HDI	高密度、轻薄、立体组装、高可靠性	
汽车电子	毫米波雷达、激光雷达、摄像头、新能源汽车	高频微波板、刚挠结合板、厚铜板	高频材料及混压、高可靠性、HDI、刚挠结合、多层板、厚铜	

2、封装基板产品

封装基板与PCB制造原理相近，是PCB适应电子封装技术快速发展而向高端技术的延伸，两者存在着一定的相关性。封装基板作为一种高端的PCB，具有高密度、高精度、高性能、小型化及薄型化等特点，是芯片封装不可或缺的一部分，不仅能够为芯片提供支撑、散热和保护作用，也为芯片与PCB母板之间提供电气连接。

公司生产的封装基板产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务/存储等领域。公司目前已形成具有自主知识产权的封装基板生产技术和工艺，建立了适应集成电路领域的运营体系，覆盖了包括器件制造商、半导体设计商以及半导体封测商等主要客户群，并与多家全球领先厂商建

立了长期稳定的合作关系，在部分细分市场上拥有领先的竞争优势。

3、电子装联

电子装联业务属于PCB制造业务的下游环节，具体系指依据设计方案将无源器件、有源器件、接插件等电子元器件通过插装、表面贴装、微组装等方式装焊在PCB上，实现电子电气的互联，并通过功能及可靠性测试，形成模块、整机或系统。公司电子装联产品按照产品形态可分为PCBA板级、功能性模块、整机产品/系统总装等，业务主要聚焦通信、医疗电子、汽车电子等领域。目前公司已具备为客户提供包括产品设计、开发、生产、装配、系统技术支持等全方位服务的能力。凭借专业的设计能力、扎实的技术实力、持续加强的智能制造能力、稳定可靠的质量口碑以及快速的客户响应，公司电子装联业务已与多家全球领先企业建立起长期战略合作关系。公司坚持深耕大客户策略，电子装联业务多年来始终保持稳定发展。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	16,792,291,128.17	14,007,819,588.20	19.88%	12,219,367,752.05
归属于上市公司股东的净资产	8,516,936,681.69	7,441,079,748.97	14.46%	5,000,803,881.38
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	13,942,521,948.74	11,600,456,950.24	20.19%	10,524,196,882.92
归属于上市公司股东的净利润	1,480,637,000.32	1,430,111,325.18	3.53%	1,232,775,470.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,271,642,082.90	1,294,094,538.71	-1.73%	1,151,701,243.26
经营活动产生的现金流量净额	2,341,812,030.05	1,799,999,047.12	30.10%	1,262,866,434.48
基本每股收益（元/股）	3.02	3.00	0.67%	2.62
稀释每股收益（元/股）	3.01	2.98	1.01%	2.61
加权平均净资产收益率	18.70%	23.86%	-5.16%	29.11%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,724,715,454.60	3,156,122,509.82	3,874,514,342.49	4,187,169,641.83
归属于上市公司股东的净利润	243,542,233.79	317,307,968.21	465,711,387.58	454,075,410.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	204,292,243.71	276,939,926.75	447,376,103.40	343,033,809.04
经营活动产生的现金流量净额	419,592,818.98	397,515,784.18	314,921,342.23	1,209,782,084.66

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

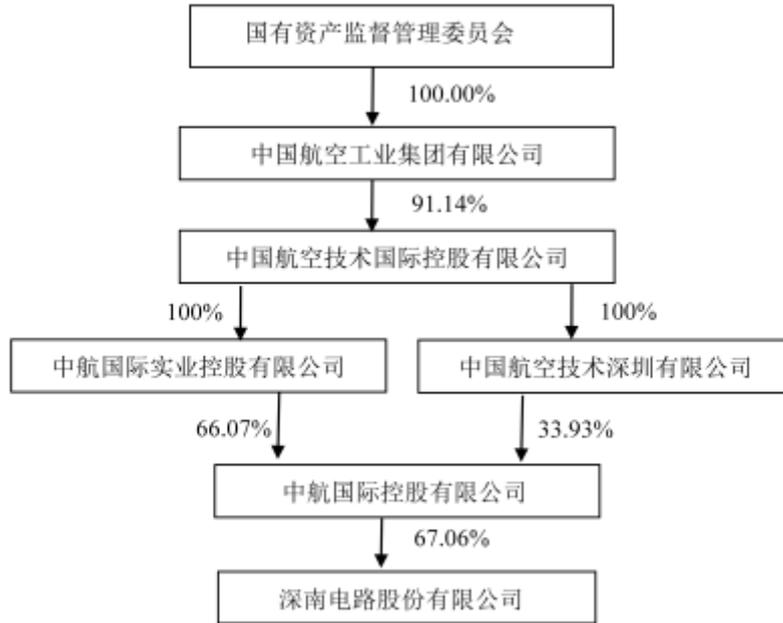
报告期末普通股股东总数	56,089	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	52,204	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中航国际控股有限公司	国有法人	67.06%	328,068,670	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	4.34%	21,253,719	0			
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.54%	2,649,629	0			
李雪红	境内自然人	0.49%	2,400,000	0			
挪威中央银行-自有资金	境外法人	0.44%	2,144,782	0			
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	0.35%	1,733,097	0			
淡水泉(北京)投资管理有限公司-淡水泉全球成长1期私募证券投资基金	其他	0.32%	1,556,316	0			
加拿大年金计划投资委员会-自有资金	境外法人	0.31%	1,493,948	0			
华润深国投信托有限公司-华润信托-淡水泉平衡5期集合资金信托计划	其他	0.30%	1,451,307	0			
陈国良	境内自然人	0.27%	1,300,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述 10 名股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东李雪红通过普通证券账户持有 170,000 股,通过信用交易担保证券账户持有 2,230,000 股,实际合计持有 2,400,000 股。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、公司新一届董事会、监事会换届选举完成，并聘任新一届高级管理人员

报告期内，公司完成了第三届董事会、监事会的换届选举，并聘任了新一届的高级管理人员。2021年3月11日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议，2021年4月6日召开了2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，公司第三届董事会、监事会换届选举完成。2021年4月6日，公司召开的第三届董事会第一次会议选举产生了公司新一届高级管理人员。

具体内容详见公司分别于2021年3月13日、4月7日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第二届董事会第二十七次会议决议》（公告编号：2021-009）、《第二届监事会第二十次会议决议》（公告编号：2021-010）、《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-024）、《第三届董事会第一次会议决议》（公告编号：2021-026）。

2、对外投资情况

2021年6月22日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于签订项目投资合作协议的议案》，同意公司与广州开发区管理委员会签订《项目投资合作协议》，拟在广州市开发区投资设立全资子公司，并以广州子公司作为项目实施主体，以公司自有资金及自筹资金60亿元建设广州封装基板基地项目。详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于6月24日披露的《关于签订项目投资合作协议的公告》（公告编号：2021-043）。

3、非公开发行A股股票

公司于2021年7月30日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及其他相关议案。本次非公开发行股票的发行对象为包括中航产投在内的不超过35名特定投资者，募集资金不超过255,000.00万元。详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于8月3日披露的《第三届董事会第四次会议决议》（公告编号：2021-052）。

非公开发行股票相关事项已于2021年10月14日、10月18日分别获得有权国资监管单位批准及公司股东大会审议通过，并于2021年12月13日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。详情请见公司分别于2021年10月16日、10月19日、12月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于非公开发行股票获得中国航空工业集团有限公司批复的公告》（公告编号：2021-075）、《2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-076）、《关于非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2021-092）。

2022年1月4日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深南电路股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许

可〔2021〕4151号），核准公司非公开发行不超过146,762,481股新股，详情请见公司于2022年1月5日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2022-001）。

本次非公开发行新增股份数 23,694,480 股，发行价格 107.62元/股，募集资金总额为 2,549,999,937.60 元，扣除各项不含税发行费用人民币20,335,154.66 元后，本次募集资金净额人民币 2,529,664,782.94 元。该等股份已于 2022 年 2 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权登记手续，2022 年 2 月 24 日在深圳证券交易所上市。详情请见公司于2022年2月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《非公开发行股票发行情况及上市公告书》。